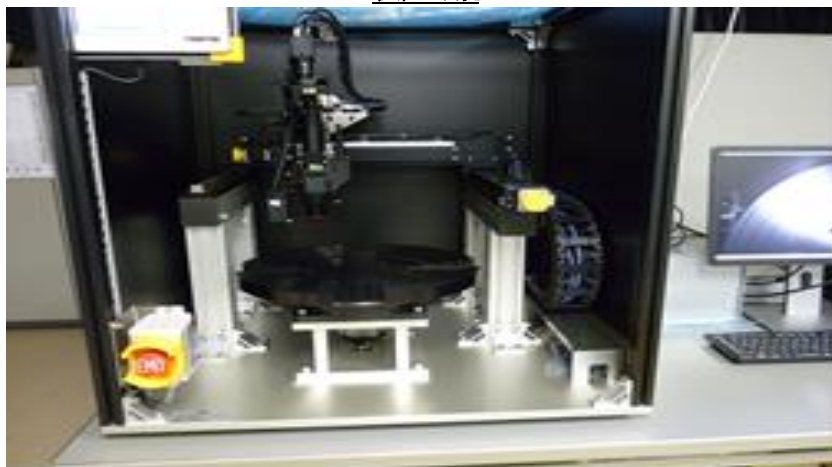


スクラッチ装置

装置外観



高精度

精密計測

カスタマイズ可

概要

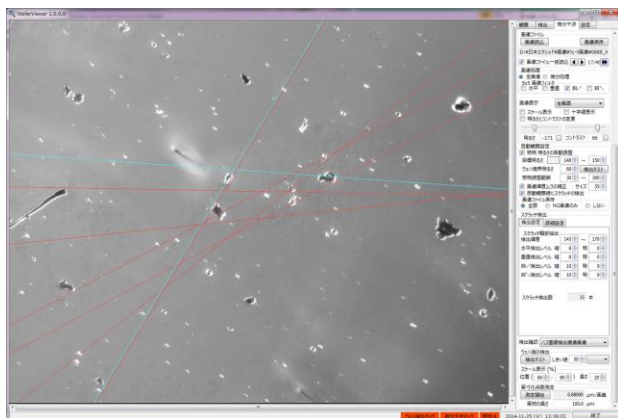
本装置はウェハを複数枚乗せる事が可能で、極微少なスクラッチ (傷)、異物、カケの外観検査を全自動で行います。ワークまでの距離を自動で測るレーザー変位計を装備しておりウェハの厚みに依存しません。プレートにウェハを乗せて、プレートを回転させて全ワークの検査を全自動で行います、検査はカメラが、XY移動いたします。画像記録のほか、任意のしきい値設定から欠陥に対してOK/NG判別を、全自動で行います。アプリケーションとして、透明体、半透明のSiCやGaN、GaAs、サファイア、シリコンなど、多彩に対応致します。ウェハサイズは4インチが基本ですが、装置カスタマイズにより12インチ迄、選択可能です。

装置仕様

- ・カメラ移動 XY軸ステージ
 - ・カメラ焦点 自動Z軸ステージ
 - ・検査用200万画素モノクロ
 - ・オリフラアライメント用カメラ
 - ・CCTVレンズ
 - ・LEDリング照明
 - ・微分干渉顕微鏡筒
 - ・画像処理用パソコン
 - ・AF用レーザー変位計
- ストローク X:230mm, Y:306mm
ストローク 39mm
(1620 x 1236 画素)
(2592 x 1944 画素)
f=10mm, 可視カットフィルタ付き
内径27mm 発光波長850nm
対物レンズ5x, 光学調整のロック機構付き
DELL Optiplex
物理的に接触しないようメカストップ機構有り

観察画面

傷のみを自動抽出：検査画像A



傷のみを自動抽出：検査画像B

